

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada proses produksi *printed circuit board assembly* (PCBA), dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan peta kendali p bahwa tidak ditemukan data proporsi yang keluar dari batas kendali dengan demikian cacat *printed circuit board assembly* (PCBA) masih dalam batas kendali. Hal ini menunjukkan kualitas produk *printed circuit board assembly* (PCBA) sudah sesuai dengan standar pada PT Flextronics Technology Indonesia. Berdasarkan hasil *first pass yield* tingkat kelulusan cacat produk cacat *solder short* tertinggi pada bulan februari 94,90 % dengan pencapaian rata-rata 94,72 % dan tingkat kelulusan produk cacat *solder blow hole* tertinggi dibulan februari 95,54 % dengan pencapaian tingkat rata-rata 98.50%.
2. Berdasarkan hasil dari analisis faktor penyebab cacat menggunakan *fishbone diagram* dapat diketahui bahwa faktor penyebab cacat *solder short* dan *solder blow hole* yaitu faktor manusia, mesin, material dan metode.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan ada beberapa saran, antara lain;

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lain yang berhubungan dengan pengendalian kualitas agar hasil penelitian dapat diketahui dengan lebih rinci.
2. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan pada jenis cacat yang lain selain *solder short solder blow hole*
3. Identifikasi cacat dengan menggunakan *fishbone* diagram bisa diterapkan pada jenis cacat selain *solder short* dan *solder blow hole*.